

Features

- APD with 0.04 mm² active area
- 230 μm diameter active area
- Optimized for red light
- Fast rise time, low capacitance
- Slow gain curve

Description

Circular active area APD chip with 230 μm diameter. Metal can type isolated, hermetic TO52 package with clear glass window. AR coating for 650 nm.

Application

- Laser range finder
- High speed photometry
- High speed optical communications
- Medical equipment

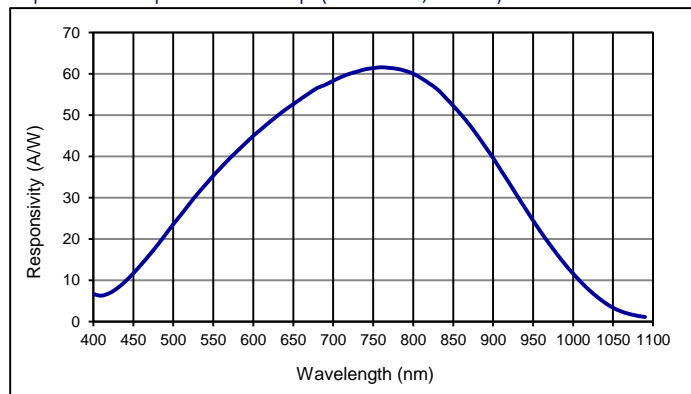
RoHS

2011/65/EU

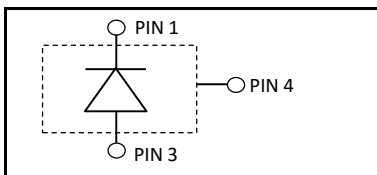
Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Min	Max	Unit
T _{STG}	Storage temp	-55	125	°C
T _{OP}	Operating temp	-40	100	°C
M _{max}	Gain (I _{PO} = 1 nA)	200		
I _{PEAK}	Peak DC current		0.25	mA

Spectral response on chip (M = 100, 23 °C)



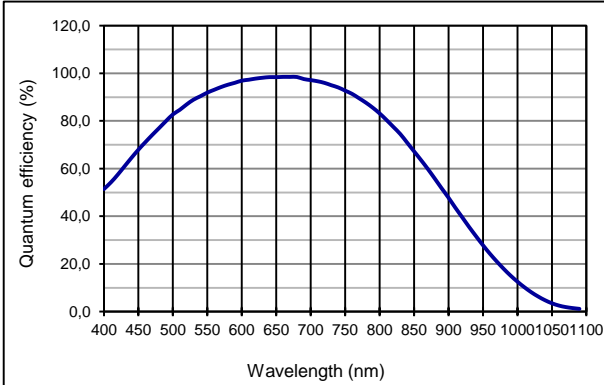
Schematic



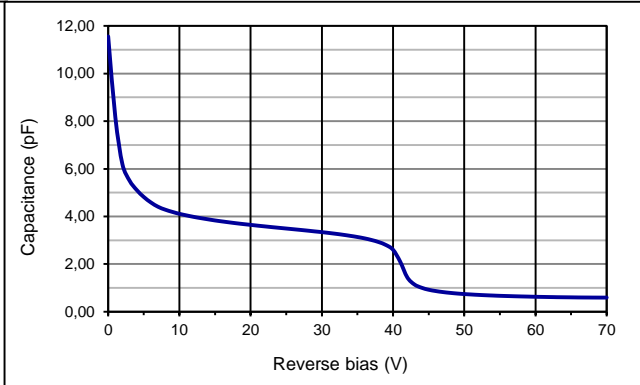
Electro-optical characteristics @ 23 °C

Symbol	Characteristic	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
	Active area		diameter 230			μm
	Active area		0.04			mm ²
I _D	Dark current	M = 100		0.2	0.5	nA
C	Capacitance	M = 100		0.6		pF
	Responsivity	M = 100; λ = 650 nm	48	53	54	A/W
t _R	Rise time	M = 100; λ = 650 nm; R _i = 50 Ω		0.18		ns
	Cut-off frequency	-3dB		2		GHz
V _{BR}	Breakdown voltage	I _R = 2 μA, other V _{BR} - binning available	80		160	V
	Temperature coefficient	Change of V _{BR} with temperature		0.45		V/K
	Excess noise factor	M = 100		2.2		
	Excess noise index	M = 100		0.2		

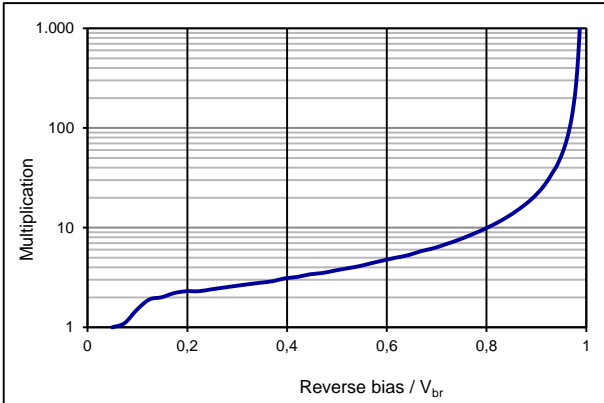
Quantum efficiency (M = 1, 23 °C)



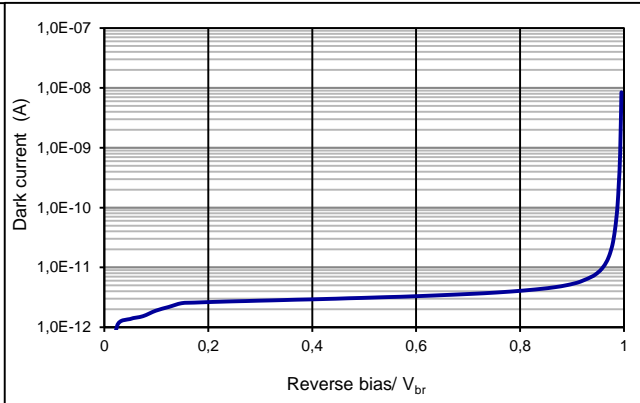
Capacitance as fct of reverse bias (23 °C)



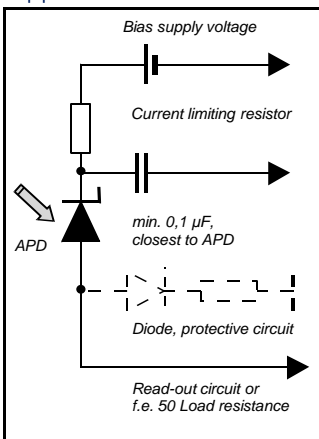
Multiplication as fct of bias and temperature



Dark current as fct of bias and temperature

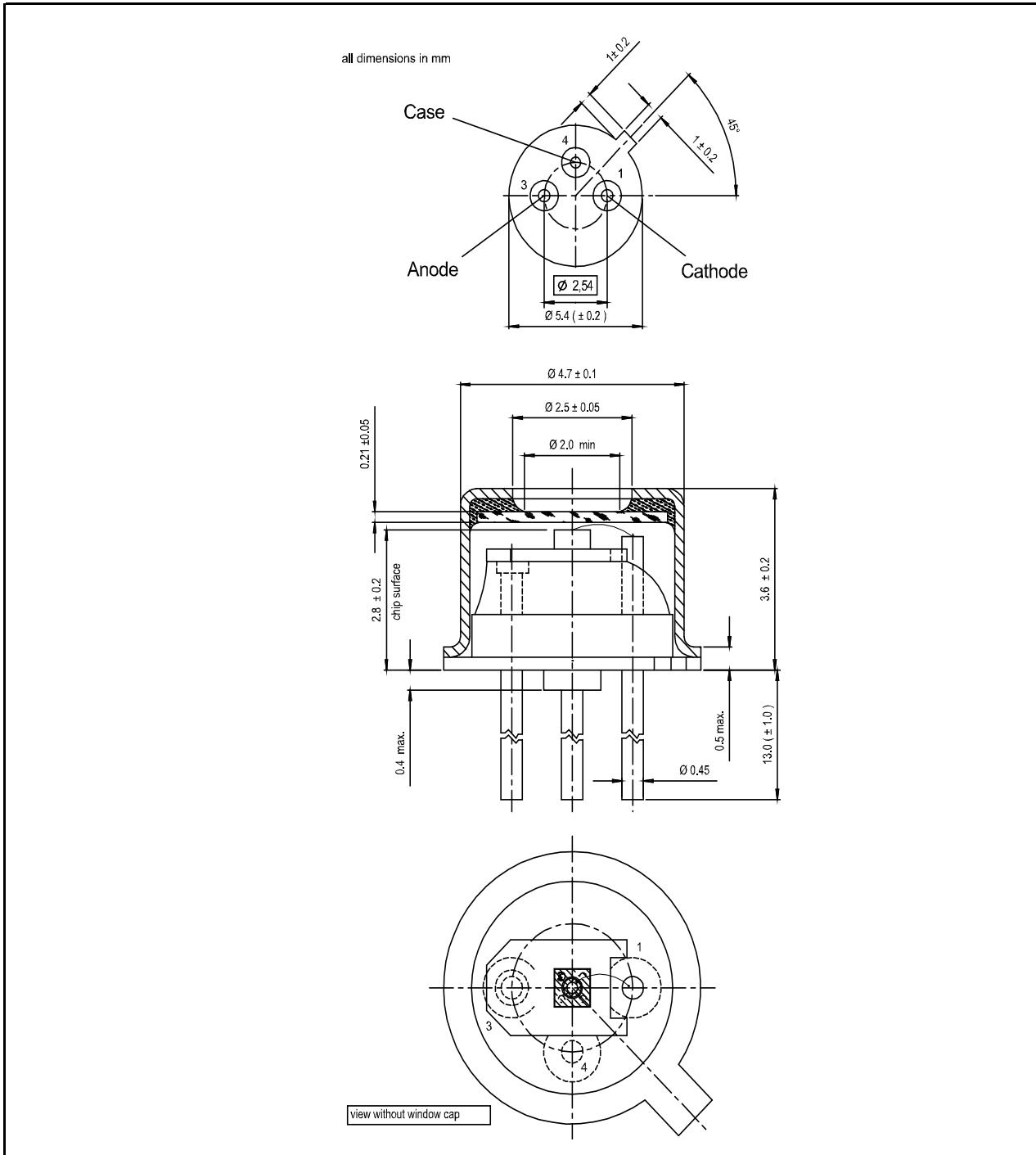


Application hints:



- Current should be limited by a protecting resistor or current limiting - IC inside the power supply
- For low light level applications blocking of ambient light should be used
- For high gain applications bias voltage should be temperature compensated
- Please consider basic ESD protection while handling
- Use low noise read-out - IC
- Optimum gain: 50-60
- For further questions please refer to document "Instructions for handling and processing"

Package: TO52S1.1



Package dimension:

Small quantities: Foam pad, boxed (12 cm x 16.5 cm)

Disclaimer: Due to our strive for continuous improvement, specifications are subject to change within our PCN policy according to JESD46C.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9